

LEITERPLATTEN-LIEFERPROGRAMM

PRODUKTE

- Einseitige Leiterplatten
- Doppelseitig-durchkontaktierte Leiterplatten
- Multilayer bis 36 Lagen, Core min. 0.05 mm
- HDI Schaltungen
- Flexschaltungen, Starrflex, Multi-Starrflex
- Metal Core (Copper / Alu)

BASISMATERIALIEN

- FR 4 (auch halogenfrei) / FR 4 High-TG
- Aluminium / Kupfer
- PTFE (Teflon), Arlon (TG250), Rogers
- Polyester-Polyimid / PET
- Kupferkaschierungen:
17.50/35/70/105/125/200/300 µm
- Brandklasse: 94 V-0

OBERFLÄCHENTECHNIK

- Hot Air Levelling (HAL)
- HAL bleifrei, RoHS
- Galv. Ni / Au (bondbar)
- Chem. Ni / Au (bondbar)
- Galv. / chem. Sn
- Kompl.- oder Selektiv-Vergoldung

DRUCKTECHNIKEN

- Carbonleitlack als
 - Schalterdruck
 - Widerstandsdruck
- Lötenschutzmasken
- Bestückungsdruck
- Fotodruck min. 3 mil

LÖTSTOPMASKEN

- Fotosensitive Flüssigsysteme bis 50 µm
- Festsysteme

GALVANIK

- Aufkupferung bis 50 µm
- Durchkontaktierung min. 25 µm

PRÜFTECHNIKEN

- 100% E-Test, Kurzschluss/Unterbruch
- Automat. Optische Prüfung (AOI)
- Sichtprüfung nach AQL
- Flying probe E-Test

MECHANISCHE BEARBEITUNG

- Bohrdurchmesser min. 3 mil
- NC-Fräsen Durchmesser min. 0.5 mm
- V-Nut ritzen (ein- und doppelseitig)
- Stanztechnik

ZULASSUNGEN / STANDARDS

- DIN EN ISO 9001, 13485, 14001, 14067 (CO₂), 16949 und AS9100
- IPC-6012 / 6013 / 6016 (Class 2/3)
- IPC A600 H (Class 2/3)
- UL, MIL, IEC, DNV
- RoHS / WEEE / REACH

August 2020

